

‘임베디드 SW 개발자 양성과정’ 모집

교육과학기술부와 한국산업기술재단이 지원하는 본 과정은 이공계 출신자들에게 임베디드시스템 전문기술 및 현장체험 교육을 실시하여 기업의 수요에 부합하는 산업기술인력양성 및 개인의 현장실무능력 향상을 목표로 하고 있습니다.

▶ 실무/실습 중심교육+산업체 연수 과정

4개월간의 전문기술교육 후 2개월의 산업체 연수를 진행하는 체계적인 프로세스에 의한 인재 양성

▶ MDS테크놀로지의 800만원 상당 무료교육

약 6개월 동안 진행되는 본 과정의 수강료에 해당하는 800만원정도의 비용은 정부에서 전액 부담

▶ 1인 1세트의 임베디드 실습 환경

고가의 실습용 보드를 1인 1세트 지급으로 가장 실질적인 교육이 가능한 최적의 실습환경 구축

▶ 1인당 220만원 연수수당 지급

6개월의 연수 기간 동안 30~50만원의 연수수당을 지급하여 연수에만 전념할 수 있는 환경 제공

□ 지원자격

- 이공계 대졸 미취업자(전문대졸, 대학원졸 포함)이며, 1977년 1월 1일 이후 출생자

- 2009년 2월 졸업예정자 포함

○ 우대대상 (가산점 10점)

• 여성인력, 2년 이상 장기실업자, 원호대상자, 장애자, 기초생활수급자

○ 지원 대상 제외자

(※ 연수생 모집공고일 기준)

• 정부실업대책 지원금 수혜자 - 실업급여 등, 동 사업에 참여하여 연수수당을 1회 이상 지급받은 자 또는 참여중인 자, 대학원 재학 중인 자, 현재 기업에 재직중인 자

□ 연수특전

- 교육비 전액 무료, 연수수당 지급(총220만원), 면접 시 출석인정, 100% 취업연계 등

□ 교육내용

- 임베디드시스템 기본기술, Firmware, OS 등

□ 교육기간 (총 6개월)

- 1차 과정 : 3/16 ~ 8/28

- 2차 과정 : 6/1 ~ 11/13 (예정)

□ 전형절차

- 서류전형 ⇒ 면접 ⇒ 최종합격

- 서류접수 : 2009. 2. 25(수)까지 첨부된 연수
지원서 작성하여 이메일 제출
(yj1709@gokea.org)

※ 1, 2차과정 동시모집

□ 문의

- 한국전자정보통신산업진흥회 인적자원개발센터 김지혜 대리

-전화 : 02-6388-6042

이메일 : yj1709@gokea.org

팩스 : 02-6388-6049

“임베디드 SW 개발자 양성 과정(1차)”

* 2차 과정은 6월 1일 부터 시행

| | | | |
|--------|-------------------------------|------|-----|
| 교육명 | 임베디드 SW 개발자 양성 과정(1차) | 교육인원 | 60명 |
| 총 교육기간 | 2009.03.16 ~ 2009.08.28 (24주) | | |

가. 전문연수

○ 전문연수계획 개요

| | | |
|-------------------|---|--------|
| 연수주제 | ■ 임베디드 전문가 양성을 위한 Firmware와 임베디드OS 교육 • Firmware 분야 : ARM 프로세서, ARM 디바이스 드라이버 • 임베디드 OS 분야 : 커널 디바이스드라이버, 어플리케이션 개발 | |
| 연수장소 | 전자산업진흥회 강의실(상암), MDS 아카데미(구로) | |
| 연수기간 | 기간 | 주 수 |
| | 2009.03.16 ~ 2009.07.03 | (16 주) |
| 연수시간 | 09:00~17:00 (1주 5일, 1일 7시간, 총 560시간 / 회차당) | |
| 연수분야별 연수생 배치계획 | 학급별 평균 30명 배치 | |

나. 기업연수

○ 유관기업 연수계획 개요

| | | |
|-----------------|--|-------|
| 연수목표 | 기업의 산업화 과정 이해 및 기업 실무적응 능력 배양 | |
| 연수기간 | 기간 | 주 수 |
| | 2009.07.06 ~ 2009.08.28 | (8 주) |
| 연수시간 | 09:00~18:00 (1주 5일, 1일 8시간, 총 320시간 / 회차당) | |
| 기업별 연수생 배치계획 | 50여개 기업에 평균 1~3명 배치 | |

■ 연수기간 중 면접 출석 인정, 취업 시 과정 정상 수료

동북아전자산업통합시스템(epartshub) '2009 한국전자부품전 공동관 참가업체 모집

1. 한국전자부품전(KEPES 2009) 개요



가. 전시회명

- 국문: 한국전자부품전
- 영문: KEPES 2009(Korea Electronic Parts & Equipment Show)

나. 전시기간 : 2009년 4월 8일 ~ 10일

다. 개최장소 : 코엑스(COEX) 3층 대서양홀, 12개국 100여개사 참가 예정

라. 주최 : 한국전자공업협동조합/K. Fairs(주)

마. 개최규모

- 참가업체 : 59개사 92부스
- 참관객 : 15,223명

바. 주요 전시품목

- DMB, PC, PDA, MLP3P, 이동통신 및 무선

통신 기기 등 각종 디지털기기 관련 전자부품

• EMC-Noise 관련 부품 및 제품

- 고주파 관련 제품

- * 디스플레이 관련부품 : LCD, PDP, FED, CRT 등
- * LED 응용제품 : FND, LED Lamp, Back Light, Dot Matrix, LED Lighting, Traffic Signal, Automotive 등
- * 광통신 부품 : 트랜스폰더, 송수신기, 모듈 레이더 등
- * 네트워크 부품 : 블루투스, 무선 랜, 무선 모뎀 등
- * 이동통신 관련부품 : 모듈, 센서, 안테나, 고주파 집적회로 등
- * 배터리
- * 스피커
- * 모터
- * 수동부품 : 저항, 코일, 콘덴서 등
- * 능동부품 : 증폭기, 다이오드, 집적회로, 트랜지스터 등
- * 보조부품 : 기판, 단자, 스위치, 커넥터 등
- * 테스트장비 및 계측장비, 부품제조장비, 임베디드 시스템 등

2. epartshub 공동 홍보관 운영 계획

가. 목적 : 중소 전자 IT 업체의 마케팅 지원

나. 대 상 : epartshub 기업회원

다. 행사기관

□ 주최 : 한국전자정보통신산업진흥회

□ 후원 : 경기도

3. 참가 안내

가. 참가신청

□ 신청자격 : epartshub 기업회원

□ 제출서류 : 참가신청서, 사업자등록증 사본 각 1부.

☞ 참가신청서 및 안내문은 www.gokea.org 알림마당에서 다운로드 가능

□ 신청방법 : 제출서류 팩스 또는 이메일 송부

□ 신청기한 : 2009. 2. 27(금) 단, 선착순 접수 마감

☞ 부스 사정 등으로 인해 조기마감 될 수 있음

□ 참가업체 선정

• 최종 참가업체는 본회 선정위원회에서 결정,

추후공지 예정

□ 참가문의 및 접수처

• 한국전자정보통신산업진흥회 마케팅지원센터
변현주 대리

- 전 화 : 02-6388-6062

- 팩스 : 02-6388-6069

- 이메일 : julie@gokea.org

□ 참가 지원내역

• 부스 임차료

• 부스 장치비(기본전력 포함)

• 진열대, 상담테이블 및 의자, 안내 데스크 등 기본비품

※ 기본비품 외의 업체카드로그 제작은 업체부담임.

